



富士康成立半导体公司聚焦功率器件

编译者：冯瑞华 发布时间：2021-5-10 点击量：17 来源栏目：产业动态

相同栏目

- 1 中国半导体
- 2 人工智能如何
- 3 广东省轻量化
- 4 瞄准包装行业
- 5 世界首条石墨
- 6 计划投资30亿
- 7 美国复合材料
- 8 中国视频电子
- 9 中科院研发
- 10 2018全球3D

热门资源

- 1 顶刊封面：5F
- 2 深圳先进院在
- 3 俄罗斯研发出
- 4 Prodways研
- 5 长跨度碳纤维
- 6 AI持续升温
- 7 IBM-Science
- 8 王中林院士N
- 9 新3D打印技
- 10 东南大学研

国巨与鸿海宣布，双方将携手成立合资公司 - 国瀚半导体 (XSemi Corporation)，共同切入半导体相关产品的开发与销售，将更深化双方在半导体领域的布局，初期锁定平均单价低于美金2元的功率、模拟半导体产品，简称小IC，进行多样的整合与发展。目前已和多家世界级半导体公司展开讨论，近期将宣布相关半导体领域的合作案。国巨董事长陈泰铭与鸿海董事长刘扬伟今日出席签署合资公司成立的合约协议。国瀚半导体将以新竹做为基地，结合双方集团的优势与资源，未来可与半导体大厂在产品的设计、制程产能、销售通路上展开多元合作，进一步构筑完整的半导体产业链，提供客户优质且供应稳定的一站式购足服务。市场预估，功率半导体产品市场在2025年将达到400亿美金的规模，类比半导体产品的市场则有250亿美金，而1台电动车的半导体使用数量比例，归类小IC的部分超过90%。

刘扬伟表示：目前半导体产业正经历30年来最大变局，产业秩序将会面临重组，现在无疑是进行多方策略合作的最佳时机。鸿海在半导体的布局已依中长期蓝图展开，作为集团布局的3大核心技术之一，产业链中已有半导体设备、设计服务、5G/AI/CIS/面板等相关IC设计、晶圆厂与系统级封装 (SiP) 等能力，配合鸿海在电动车、数位健康、机器人3大新兴产业的转型需求，进而扩大垂直整合产业链。陈泰铭表示：「国巨著眼的是提供客户1次购足的长期发展，此合作更符合客户优化供应链的需求。」这次藉由此小IC合资公司的成立，可进一步将产品线从被动元件扩及至半导体主动元件，提供现有客户更完整的元件供应，为国巨集团带来极大的成长空间。鸿海在半导体布局已依中长期蓝图展开，作为集团布局的三大核心技术之一，产业链中已有半导体设备、设计服务，以及5G、人工智能、CMOS影像感测元件及面板等相关IC设计、晶圆厂与系统级封装 (SiP) 等能力，配合鸿海在电动车、数位健康、机器人3大新兴产业的转型需求。国巨集团在合并美国基美 (KEMET)、普思 (Pulse) 后，着重布局高阶规格产品，例如国巨在电动车关键零组件的解决方案包括动力传动机构 (powertrain)、电池管理系统、先进驾驶辅助系统 (ADAS)，以及智能医疗、工业规格、5G技术等，都已有具体实绩。

来源机构 新材料在线

原文题目 富士康成立半导体公司，聚焦功率器件

原文来源 http://www.xincailliao.com/news/news_detail.aspx?id=592928

上一篇：[没有了](#)

下一篇：[铜陵有色参与设超10亿元规模产业基金...](#)

提供服务： [导出本资源](#)